专注液态金属9年

高性能液态金属热管理技术



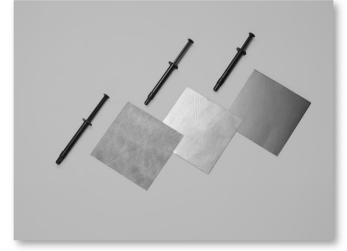
- 01 世界领先的液态金属"黑科技"新材料企业
- 02 致力于打造低熔点液态金属产业应用生 态集群

概念介绍

液态金属,已知液体里面,导电导热最强的,常温下呈液态。

- 主要是围绕低熔点液态金属合金,像镓基、铟基、铋基三大类,安全环保的界面材料
- 聚焦产业转化应用,全力打造低熔点 液态金属材料研发及产业应用领域第 一品牌
- 完善的低熔点液态金属材料体系
- 成熟的低熔点液态金属材料制备工艺
- 作为"前沿新材料"列入国家《重点 新材料首批次应用示范指导目录》







● 应用

普遍用于发热器件和散 热的材料,主要用于填 补两种材料结合或接触 时产生的微空隙及表面 凹凸不平的孔洞,减少 传热接触热阻,提高器 件散热性能。

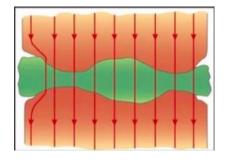
● 原理

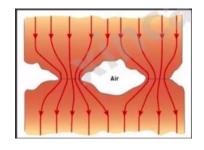
空气热导率只有 0.024W/(m K),是热 的不良导体,导致电子 元件与散热器之间的接 触热阻非常大,阻碍热 量传导,降低散热器性 能。

● 作用

使用具有高导热性的热 界面材料填充满这些间隙,排除其中的空气, 在电子元件与散热器中间建立有效的热传导通道,大幅降低接触热阻, 充分发挥散热器的作用。

低熔点液态金属导 热界面材料





生产及流程

轧制 轧制 检测 熔炼 浇铸 模切 配料 (粗) (精) 包装 2 3 5 M 6 M

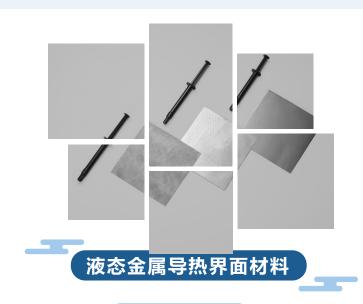
- 深圳:集团总部/研发总部/ 生产
 - ❖核心专利体系建设
 - ❖核心研发团队建设
 - 操作便捷性优于现有热界面材 料。
- 销售中心
 - ❖消费电子
 - ◆低功率器件

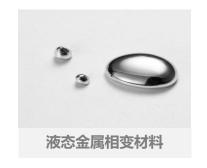


- 重庆: 液态金属生产制造基地
 - ❖标准化生产线及生产许可
 - ❖ISO标准体系认证
 - *持续的规模化生产能力
- 液态金属销售中心
 - ◆主要针对芯片封装、激光、 LED、LD、Uv固化等
 - ◆主要针对电力、电子、通讯、 光伏、新能源、服务器
 - • 主要针对航天、军工市场

产品体系: 散热产品为主, 拓展产品为辅







应用领域

流动循环传热系统

高性能计算机冷却 激光器、雷达散热

通讯基站散热 动力电池温控

红外感应设备热控 高温余热回收

太阳能光热利用 生物质焚烧发电

IGBT

高性能服务器

CPU&GPU

通讯基站

TR组件 \激光器

精密光电器件

浸没式服务器

大功率LED

液态金属相变储能技术

军用激光

大功率脉冲设备

移动电子

雷达系统

无源冷链配送

建筑涂料

控温产品

新能源

导热界面材料



产品优势

- ◆导热率为传统硅油基材料的5-10倍,热响应快,性能优势明显
- ❖综合热阻小,界面+接触
- ◆物化性质稳定,安全环保,不油离干涸,更适合高温、高热流场合的长期应用;
- ◆不挥发,不污染光学器件,在激光器等光学器件上应用为同类产品中最佳选择,具有排他性优势;
- ◆耐高温能力达500℃,远高于现有热界面材料;
- ◆浸沉环境中有机溶液亦可安全使用,兼容使用冷却液
- ◆可重复使用,售后成本低,操作便捷等性优于现有热界面材料。

产品选型

型号	单位	ZJ-I	ZJ-II	ZJ-III	ZJ-198	LM-I-N(平面& 花纹)	ZJ-GI	ZJ-GII	ZJ-PC50	ZJ-PCC10	标准
颜色	-	亮银色	亮银色	亮银色	亮银色	亮银色	亮银色	亮银色	亮银色	灰银色	目测
组分系列	-		LM-P系列	铋基合金		LM-I 铟基合金	LM-G	镓基合金	LM-PC	镓基复合	-
热导率	W/m·K	60	60	70	60	80	25	12	50	10	ASTM D5470
使用范围	°C	-50 ~ 500	-50 ~ 500	-50 ~ 500	-50 ~ 500	-50 ~ 150	-50 ~ 500	-50 ~ 500	-50 ~ 500	-50-180	-
密度	g/cm3	7.9	7	7	7	7.3	5.5	5.5	6	6	GB/T 1423- 1996
击穿强度	KV/mm									0.46	ASTM D149-09
电阻率	Ω·m	8.3×10-8	9×10-8	9×10-8	9×10-8	8.4×10-8	1.2×10-7	1.2×10-7	1.2×10-7		GB/T6 146- 2010
挥发率	-	< 0.001%	< 0.001%	< 0.001%	< 0.001%	< 0.001%	< 0.001%	< 0.001%	< 0.001%	< 0.001%	-
粘度	mPa.s	6000 (熔后)	6000 (熔后)	6000 (熔后)	6000 (熔后)		4200	8200	4500	4500	ASTM D3835
熔点	℃	60	72	118	198	150					GB/T 1425- 1996

产品需求,可以根据客户要求 (熔点、厚度等具体参数) 定制产品

*花纹款表面有凸起结构,可压缩率 40%, 大幅降低接触热阻

液态金属原液 (高导热导电)



液态金属原液具有高电导率、高沸点、高热导 率、良好的浸润性、ROSH环保、非易熔易爆, 可根据不同的应用场整调整其熔点。

液态金属原液	单位	参数	检测标准
顏色	/	亮銀色液体	目測
导热系数	W/m. K	20~100W	可调
熔点	°C	8	可调
密度	g/cm³	6.2	GB/T 1423- 1996
粘度	m²/s	3×10 ⁻⁷	ASTMD 3835
+ - *	C /	2 5106	
电导率	S/m	3.5×10 ⁶	
电导率 液态温区	5/m ℃	-5℃~2000℃	



高温工业 余热回收





电脑流动 散热系统



相变蓄热 装置



工矿灯LED 散热器



降温保温控 温杯

液态金属导热片(高导热导电)

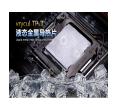


01

LM-P系列产品是 一款纯金属导热片, 用于散热器与发热 元件层间,利用低 熔点相变吸热特性 填充界面间隙形成 良好的散热通道。 02

不含硅油等易挥发物质、可靠性高, 超长使用寿命。

型号	单位	参数	检测标准
顏色	/	亮銀色	目測
導熱係數	W/m. K	60~80	ASTM D5470
比熱容	(J/Kg∙K)	300	ASTM E1269
密度	g/cm³	7.9	GB/T 1423- 1996
厚 度	mm	0.05 ~ 0.3	可定制
相變化溫度	°C	60-198	GB/T 1426-1996
體積電阻率	Ω•m	0.9×10-7	GB/T6 146- 2010
使用溫度	°C	-50 to 500	***
腐蚀性	***	无	***







CPU芯片

芯片激光器

伺服器



TIM1.5

LED前大灯

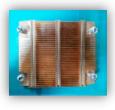
IGBT控制模块

液态金属导热膏 (高导热导电)



LM-G系列产品是一款纯金属导热膏,广泛用于高温、高热流密度电子器件的填充散热,取代传统导热硅脂产品、无挥发、对铝腐蚀。

型号	单位	参数	检测标准
颜色	/	亮银色	目测
组分	/	镓基合金	
導熱係數	W/m. K	12~25	ASTM D5470
密度	g/cm³	6.2	GB/T 1423-1996
粘度	mPa.s	4200	ASTM D3835
體積電阻 率	Ω•m	1.2×10-7	GB/T6 146-2010
使用溫度	℃	-50 to 500	***
腐蚀性	***	铝及其合金	***







芯片散热器

电脑

激光雷达

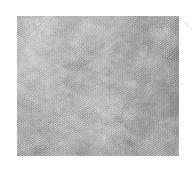




功率管

电缆连接

LM-I系列导热片(高导热导电高压缩)*_{重点推荐}





0 1

LM-I系列的凸起结构具有 40%以上的高压缩性,能大 副降低接触热阻,性能远优 于传统的硅基垫片,目前主 要在浸沉式服务器、航天军 工电子等领域应用。



02

兼容浸没环境的有机溶液,无挥发,不会影响光学器件,在光电器件散热方面极具优势。

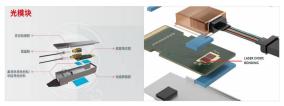
型 号	单位	参数	检测标准
顏色	/	亮銀色	目測
導熱係數	W/m. K	80	ASTM D5470
密度	g/cm³	7.3	GB/T 1423-1996
厚度	mm	0.05 ~ 0.3	可定制
相變化溫度	°C	150	GB/T 1426-1996
體積電阻率	Ω•m	0.3×10-6	GB/T6 146-2010
使用溫度	°C	-50 to 150	***
腐蚀性	***	压力要求	施加压紧力不小于 3Kg/cm²





高性能手机

服务器



光模块

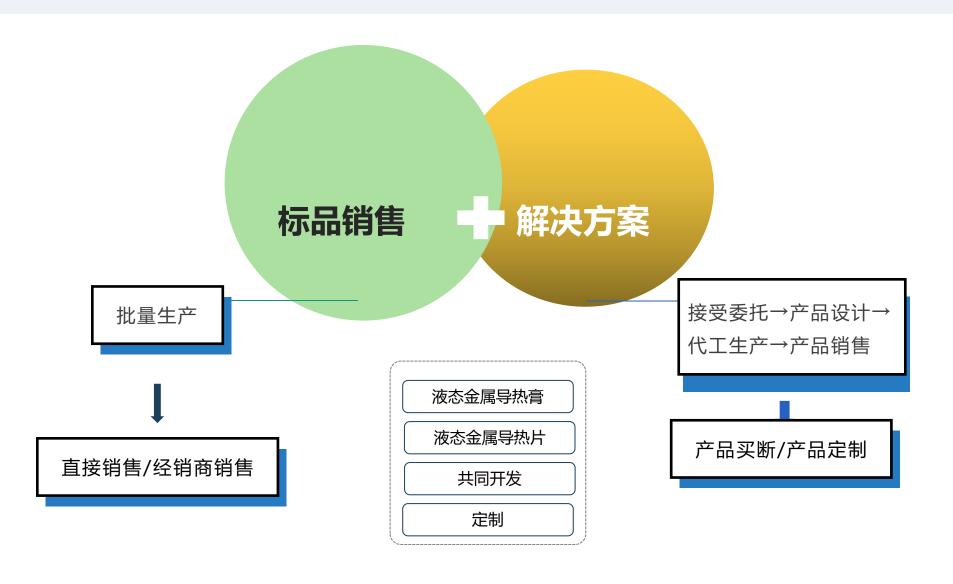


LM-I系列导热片 (浸没式服务器应用)



LM-I系列导热片(航天、军工)

商业模式:标品销售和定制化解决方案



THANKS

专注. 聚焦.液态金属